

2021-2026年中国绝缘栅双极晶体管市场全面调研 及行业投资潜力预测报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国绝缘栅双极晶体管市场全面调研及行业投资潜力预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/electric/725486.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

绝缘栅双极晶体管（Insulate-Gate Bipolar Transistor—IGBT）综合了电力晶体管（Giant Transistor—GTR）和电力场效应晶体管（Power MOSFET）的优点，具有良好的特性，应用领域很广泛；IGBT也是三端器件：栅极，集电极和发射极。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 绝缘栅双极型晶体管（IGBT）行业相关概述

1.1 功率半导体相关介绍

1.1.1 基本概念

1.1.2 性能对比

1.1.3 应用范围

1.2 IGBT相关概述

1.2.1 基本概念

1.2.2 基本分类

1.2.3 产品类别

第二章 2016-2020年功率半导体产业发展综合分析

2.1 2016-2020年全球功率半导体发展分析

2.1.1 发展驱动因素

2.1.2 市场发展规模

2.1.3 细分市场占比

2.1.4 企业竞争格局

2.1.5 应用领域状况

2.1.6 厂商扩产情况

2.2 2016-2020年中国功率半导体发展分析

2.2.1 行业发展特点

2.2.2 市场发展规模

2.2.3 市场竞争格局

2.2.4 支持基金分布

2.2.5 企业研发状况

2.2.6 下游应用状况

2.3 功率半导体行业项目投资案例

2.3.1 项目基本概况

2.3.2 项目投资计划

2.3.3 项目投资必要性

2.3.4 项目投资可行性

2.4 功率半导体产业发展困境及建议

2.4.1 行业发展困境

2.4.2 行业发展建议

第三章 2016-2020年IGBT行业发展环境分析

3.1 政策环境

3.1.1 行业监管主体部门

3.1.2 行业相关政策汇总

3.1.3 产业目录引导发展

3.1.4 集成电路税收政策

3.1.5 新能源汽车政策推动

3.2 经济环境

3.2.1 世界经济形势分析

3.2.2 国内宏观经济概况

3.2.3 工业经济运行状况

3.2.4 未来经济发展走势

3.3 社会环境

3.3.1 居民收入水平

3.3.2 居民消费结构

3.3.3 社会消费规模

第四章 2016-2020年IGBT行业发展综合分析

4.1 2016-2020年全球IGBT行业发展分析

4.1.1 行业发展历程

4.1.2 市场发展规模

4.1.3 市场竞争格局

4.1.4 下游应用占比

4.2 2016-2020年中国IGBT行业发展分析

4.2.1 需求驱动因素

4.2.2 市场发展规模

4.2.3 市场竞争格局

4.2.4 企业技术布局

4.2.5 应用领域分布

4.3 IGBT行业商业模式分析

4.3.1 无工厂芯片供应商（Fabless）模式

4.3.2 代工厂（Foundry）模式

4.3.3 集成器件制造（IDM）模式

4.4 IGBT产业链发展分析

4.4.1 产业链条结构

4.4.2 产业核心环节

4.4.3 上游领域分析

4.4.4 下游领域分析

第五章 2016-2020年IGBT技术研发状况

5.1 IGBT技术进展及挑战分析

5.1.1 封装技术分析

5.1.2 车用技术要求

5.1.3 技术发展挑战

5.2 车规级IGBT芯片技术发展分析

5.2.1 大电流密度和低损耗技术

5.2.2 高压/高温技术

5.2.3 智能集成技术

5.3 车规级IGBT模块封装技术

5.3.1 芯片表面互连技术

5.3.2 贴片互连技术

5.3.3 端子引出技术

5.3.4 散热设计技术

5.4 车规级IGBT的技术挑战与解决方案

5.4.1 主要技术挑战

5.4.2 技术解决方案

第六章 2016-2020年IGBT行业上游材料及设备发展综合分析

6.1 2016-2020年IGBT行业上游材料发展分析——硅晶圆

6.1.1 营收发展规模

6.1.2 行业产能状况

6.1.3 产能分布趋势

6.1.4 出货面积情况

6.1.5 需求结构分析

6.2 2016-2020年IGBT行业上游材料发展分析——光刻胶

6.2.1 行业基本概述

6.2.2 产品基本类型

6.2.3 市场发展规模

6.2.4 市场竞争格局

6.2.5 细分市场格局

6.2.6 行业发展趋势

6.3 2016-2020年IGBT行业上游设备发展分析——光刻机

6.3.1 技术迭代状况

6.3.2 市场发展规模

6.3.3 市场竞争格局

6.3.4 细分市场格局

6.3.5 产品结构状况

6.4 2016-2020年IGBT行业上游设备发展分析——刻蚀设备

6.4.1 刻蚀需求特点

6.4.2 市场发展规模

6.4.3 市场竞争格局

6.4.4 国内企业发展

第七章 2016-2020年IGBT行业下游应用领域发展综合分析

7.1 2016-2020年新能源汽车领域发展分析

7.1.1 汽车产销状况

7.1.2 充电桩保有量

7.1.3 应用场景分析

7.1.4 成本构成分析

7.1.5 市场竞争格局

7.1.6 市场规模预测

7.2 2016-2020年新能源发电领域发展分析

7.2.1 应用场景分析

7.2.2 应用需求特点

7.2.3 风电新增装机量

7.2.4 光伏新增装机量

7.2.5 市场竞争格局

7.2.6 市场规模预测

7.3 2016-2020年工业控制领域发展分析

7.3.1 市场发展规模

7.3.2 应用场景分析

7.3.3 市场竞争格局

7.3.4 市场规模预测

7.3.5 未来发展展望

7.4 2016-2020年变频家电领域发展分析

7.4.1 应用优势分析

7.4.2 变频家电销量

7.4.3 市场竞争格局

7.4.4 应用前景展望

7.5 2016-2020年其他应用领域发展分析

7.5.1 轨道交通领域

7.5.2 特高压输电领域

第八章 2016-2020年IGBT行业国外重点企业经营分析

8.1 英飞凌 (Infineon)

8.2 安森美 (ON Semiconductor)

8.3 东芝 (Toshiba Corporation)

8.4 三菱电机

第九章 2016-2020年IGBT行业国内重点企业经营分析

9.1 比亚迪股份有限公司

9.1.1 企业发展概况

9.1.2 经营效益分析

9.1.3 业务经营分析

9.1.4 财务状况分析

9.2 吉林华微电子股份有限公司

9.2.1 企业发展概况

9.2.2 经营效益分析

9.2.3 业务经营分析

9.3 杭州士兰微电子股份有限公司

9.3.1 企业发展概况

9.3.2 经营效益分析

9.3.3 业务经营分析

9.3.4 财务状况分析

9.4 天津中环半导体股份有限公司

9.4.1 企业发展概况

9.4.2 经营效益分析

9.4.3 业务经营分析

9.4.4 财务状况分析

第十章 IGBT行业投资分析及风险提示

10.1 IGBT行业投资机遇分析

10.1.1 契合政策发展机遇

10.1.2 国产替代发展机遇

10.1.3 能效标准规定机遇

10.2 IGBT行业投资项目动态

10.2.1 赛晶亚太IGBT项目落地

10.2.2 比亚迪IGBT项目启动建设

10.2.3 台芯科技IGBT模块项目

10.2.4 英飞凌无锡IGBT生产项目

10.3 IGBT行业投资壁垒分析

10.3.1 技术壁垒

10.3.2 品牌壁垒

10.3.3 资金壁垒

10.3.4 人才壁垒

10.4 IGBT行业投资风险预警

10.4.1 产品研发风险

10.4.2 技术泄密风险

10.4.3 市场竞争加剧风险

10.4.4 宏观经济波动风险

10.4.5 利润水平变动风险

第十一章 2021-2026年中国IGBT行业发展前景趋势预测(AK HT)

11.1 IGBT行业发展趋势分析

11.1.1 行业发展方向

11.1.2 企业发展趋势

11.2 中投顾问对2021-2026年中国IGBT行业预测分析

11.2.1 2021-2026年中国IGBT行业影响因素分析

11.2.2 2021-2026年全球IGBT市场规模预测

11.2.3 2021-2026年中国IGBT市场规模预测

图表目录：

图表：功率半导体应用范围

图表：功率半导体厂商扩产情况

图表：中国功率半导体市场发展特点

图表：2020年中国半导体功率器件十强企业

图表：功率半导体器件领域期刊文献基金分布

图表：2016-2020年中国功率半导体主要厂商研发支出

图表：2016-2020年国内功率半导体厂商研发人员数量

图表：2020年中国半导体下游应用占比

图表：IGBT行业相关政策汇总

图表：2016-2020年国内生产总值及其增长速度

图表：2016-2020年三次产业增加值占国内生产总值比重

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/electric/725486.html>